

2023年度精密工学会秋季大会 学生研究発表会募集について

学生研究発表会（ポスター形式）を下記のとおり開催します。本発表会は大学院，大学，高専に所属する学生を対象とします。また，一般講演（口頭発表）を申し込まれた方も同じ内容でポスター発表することが可能です。奮ってご参加ください。

1. 開催日 2023年9月13日（水）（大会第1日目） ポスター発表 13時～15時，表彰式 19時～20時30分
2. 会場 福岡工業大学 E棟3F 機器展示ブースおよび周辺教室（福岡県福岡市東区和白東3-30-1）
3. 発表申込締切 2023年7月7日（金）17時まで（厳守）
4. 原稿締切 2023年7月28日（金）17時（必着）
5. 発表論文公開予定 2023年8月31日（金）（学会ウェブサイトにて公開予定）
6. 発表申込について
 - 発表申込は締切期日までに発表申込受付ウェブページから行ってください。
問合せ先：2023年度秋季大会実行委員会（担当：熊本大学 久保田章亀）
E-mail: kubota@mech.kumamoto-u.ac.jp Tel: 096-342-3764
 - 発表者は会員・非会員を問いません。なお，発表者を筆頭に申し込んでいただきますが，発表原稿での著者の順番は，これに従う必要はありません。また，指導者と連名での申込みを原則とします。
 - 会場の上限人数に達した場合，申し込み期限よりも早く参加申込みを締め切ることがあります。
 - 発表申込金は以下の通りです。

一般講演で発表する 学生会員・ 学生会員 Web 級	無料	一般講演（口頭発表）を申し込まれている方は，費用は掛かりません。
一般講演で発表しない 学生会員・ 学生会員 Web 級	5,000 円（税込）	一般講演（口頭発表）を申し込まれていない方は，費用が発生します。
一般講演で発表する 非会員学生	無料	一般講演（口頭発表）を申し込まれている方は，費用は掛かりませんが，企業賞の対象にはなりません。
一般講演で発表しない 非会員学生	11,000 円（税込）	学生研究発表会でポスター発表できますが，企業賞の対象にはなりません。この機会に学生会員・学生会員 Web 級への入会をお勧めします。

- 発表原稿は A4 判 1 ページ以上 2 ページ以内とし，「学生研究発表会 PDF 原稿の書き方・見本」をご参照のうえ作成し，期日までに指定のウェブページから提出してください。なお，一般講演（口頭発表）と同じ内容でポスター発表する方は，一般講演で提出された講演原稿をそのまま流用いたしますので，発表原稿を提出いただく必要はありません。
 - 発表の取消しは参加者に迷惑をかけ，実行委員会が準備をすすめるうえでも支障をきたしますので，発表取消は行わないよう注意願います。
 - 学生研究発表論文およびポスターに用いる言語は日本語または英語とします。
 - 学生研究発表論文の著作権および要旨（発表概要）の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。本会の著作権は複製権，翻案権，翻訳権を含みます。
7. 発表申込の入力要領
 - 同一題目の第 1 報～第 n 報には必ず副題を入れてください。
 - 要旨はポスタープログラム作成の際参考とするものです。内容（要点）を簡潔に記入してください。
 - 分類・コードの入力については，別紙一覧表から発表内容にふさわしいキーワードを選択し，その分類・コードを所定欄に入力してください。

8. ポスターの作成について

- ポスターには講演番号・講演題目・共著者名を必ず記載してください。ポスターサイズは、A1 サイズとします。

9. ポスターの掲示について

- ポスターは、発表者の責任で9月13日（水）（大会第1日目）の開始時刻13:00までに、決められた場所に掲示してください。時間までに掲示されなかったポスターは、発表中止として取り扱われる場合がありますのでご注意ください。

10. ポスター発表者間の交流について

- プレゼンテーションタイムと交流タイムを設定し、学生同士、学生と企業関係者との交流の機会を作ります。日頃、分野的に異なる研究テーマの方とも積極的に交流して、ご自身の研究の幅を広げる機会としてください。

11. 企業賞について

- 優れたポスター発表者には、「企業賞」を贈賞します。企業の視点で優れていると判断できる学生のポスター発表に対し、先端技術・機器展示会に出展した企業名を冠した賞が贈賞されます。企業賞はスポンサー企業の審査員が、それぞれの企業の判断で選考します。今大会では、企業賞に副賞もご協力頂いていますので、ポスター発表参加者は19時からの懇談会も出席してください。

2023年度精密工学会秋季大会 学生研究発表会 分類・コード・キーワード一覧

<分類表>

A : 設計・生産システム B : 精密加工 C : メカトロクス・精密機器 D : 精密計測 E : 人・環境工学
 F : 材料・表面プロセス G : バイオエンジニアリング H : ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
A	01	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	意匠設計 (スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニュファクチャリング
A	04	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術 (画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS (Product-Service Systems, 製品サービスシステム), 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	99	設計・生産システム一般
B	01	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	超砥粒ホイール, 研削, ツルイング・ドレッシング, 研削盤
B	08	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	10	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	11	ポリシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	磁場・電場援用研磨 (加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術 (スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工 (含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	レーザー加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	切削機構, 切削温度, 工具摩耗, 仕上げ面評価, 切削状態監視, 知能化切削, 切削シミュレーション
B	17	付加製造, 3Dプリンティング, M I D
B	19	データサイエンス, AI, IoT, DX
B	99	精密加工一般

2023年度精密工学会秋季大会 学生研究発表会 分類・コード・キーワード一覧

<分類表>

A : 設計・生産システム B : 精密加工 C : メカトロニクス・精密機器 D : 精密計測 E : 人・環境工学
 F : 材料・表面プロセス G : バイオエンジニアリング H : ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
C	01	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	機能性材料を応用したセンサ・アクチュエータ, 新原理によるセンサ・アクチュエータ, 超音波デバイスとその応用, センサ・アクチュエータ制御手法
C	03	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	05	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化, 微小部品加工
C	99	メカトロニクス・精密機器一般
D	01	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	知的計測
D	03	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リソグラフィ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
D	99	精密計測一般
E	01	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
E	99	人・環境工学一般
F	01	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	99	材料・表面プロセス一般
G	01	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
G	99	バイオエンジニアリング一般
H	01	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニファクチャリングシステム, アセンブリシステム, デザインシステム
H	03	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント, 電子ビーム描画技術
H	04	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
H	99	ナノテクノロジー・新領域一般